

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2005-521207
(P2005-521207A)

(43) 公表日 平成17年7月14日(2005.7.14)

(51) Int.Cl.⁷

H05B 33/22
G09F 9/30
H05B 33/10
H05B 33/12
H05B 33/14

F 1

H05B 33/22
G09F 9/30
H05B 33/10
H05B 33/12
H05B 33/14

テーマコード(参考)

Z
3K007
338
5C094
365Z

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 19 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2003-577343 (P2003-577343)
(86) (22) 出願日 平成15年3月19日 (2003.3.19)
(85) 翻訳文提出日 平成16年9月16日 (2004.9.16)
(86) 國際出願番号 PCT/IB2003/001000
(87) 國際公開番号 WO2003/079449
(87) 國際公開日 平成15年9月25日 (2003.9.25)
(31) 優先権主張番号 0206551.4
(32) 優先日 平成14年3月20日 (2002.3.20)
(33) 優先権主張国 英国(GB)
(31) 優先権主張番号 0209562.8
(32) 優先日 平成14年4月26日 (2002.4.26)
(33) 優先権主張国 英国(GB)
(31) 優先権主張番号 0216055.4
(32) 優先日 平成14年7月11日 (2002.7.11)
(33) 優先権主張国 英国(GB)

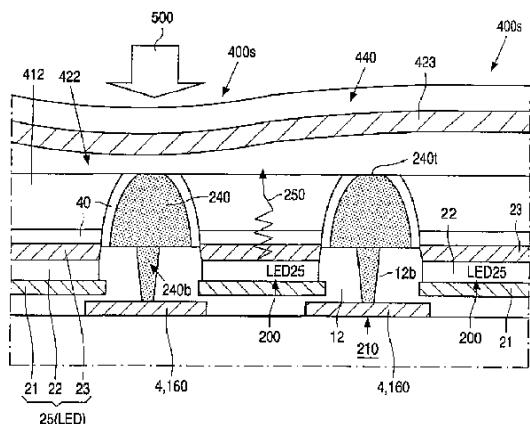
(71) 出願人 590000248
コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ
Koninklijke Philips Electronics N. V.
オランダ国 5621 ベーー アインドーフェン フルーネヴァウツウェッハ
1
Groenewoudseweg 1, 5
621 BA Eindhoven, The Netherlands
(74) 代理人 100070150
弁理士 伊東 忠彦
(74) 代理人 100091214
弁理士 大貫 進介

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置及びその製造方法

(57) 【要約】

物理的障壁(210)は、特に有機半導体材料のLED(25)を有するアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置の回路基板(100)における隣接画素(200)間にある。本発明は、回路基板の第1回路素子(21、4、5、6、140、150、160、T1、T2、Tm、Tg、Ch)と、第2回路素子であって、例えば、画素アレイに亘って支持されるセンサアレイのセンサ(400s)との間の相互接続としての機能を果たす電気導電性材料(240)を有する障壁(210)を形成する。導電性障壁材料(240)は、LEDに隣接する障壁の側部において絶縁され、第2回路素子(400、400s、23)が導電性障壁材料(240)に接続される非絶縁性上部接続領域(240t)を有する。



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

画素のアレイが該アレイの少なくとも 1 つの方向において少なくとも幾つかの隣接画素間の物理的障壁を有して存在する、回路基板；

を有する、アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、

各々の画素はエレクトロルミネッセンス素子を有し；

前記回路基板は、前記エレクトロルミネッセンス素子が接続される回路構成を有し；

前記物理的障壁は、前記回路基板の第 1 回路素子と前記装置の第 2 回路素子との間の相互接続としての機能を果たす導電性材料を有し；

前記導電性障壁材料は前記エレクトロルミネッセンス素子に隣接する障壁の少なくとも側部において絶縁され、非絶縁性である上部接続領域と下部接続領域とを有し、前記第 1 回路素子と前記第 2 回路素子とは前記導電性障壁材料に接続されている；

ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、前記回路基板の前記第 1 回路素子は：

導体層；

電極接続；

供給ライン；

アドレスライン；

信号ライン；

薄膜トランジスタ； 及び

薄膜キャパシタ；

を有するグループの少なくとも 1 つの薄膜素子である、ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 3】

請求項 1 に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、前記第 2 回路素子は前記エレクトロルミネッセンス素子の上部電極であり、前記第 1 回路素子は前記回路基板の少なくとも 1 つの薄膜素子である、ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 4】

請求項 3 に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、各々の画素は、隣り合っている副画素であって、それら副画素間に障壁を有し、1 つのサブ画素の前記上部電極を隣接副画素の前記下部電極に接続する導電性障壁材料を有する、副画素、を有し、それらの上部電極及び下部電極は前記第 1 回路素子及び前記第 2 回路素子を構成する、ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 5】

請求項 1 又は 2 に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、センサのアレイが前記画素のアレイと共に集積化され、前記センサは、前記回路基板の前記第 1 回路素子に前記導電性障壁材料により接続された前記第 2 回路素子を提供する、ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 6】

請求項 1 乃至 5 のいずれ一項に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、センサのアレイは前記画素のアレイと共に集積化され、前記回路基板は、前記の画素のアレイ及び前記のセンサのアレイの両方のためのマトリクス状アドレス回路構成を有し、そして、前記導電性障壁材料は前記マトリクス状アドレス回路構成に前記アレイのセンサを接続する、ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 7】

10

20

30

40

50

請求項 5 又は 6 に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、前記センサアレイは、前記障壁の上部において及び前記画素アレイに亘って支持される、ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 8】

請求項 7 に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、平坦化層は、前記画素アレイに亘って前記センサアレイを支持するために前記障壁の疵気上部に延びる膜厚を有する前記画素アレイに亘ってある、ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 9】

請求項 1 乃至 8 のいずれ一項に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、前記障壁の絶縁性距離部は前記導電性障壁材料（及び、好適には、金属を有する）を主体としている、ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

10

【請求項 10】

請求項 1 乃至 9 のいずれ一項に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、前記障壁は、前記第 1 回路素子に接続され、少なくとも前記障壁の側部における絶縁性コーティングを有する前記導電性障壁材料を与える金属コアを有する、ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 11】

請求項 1 乃至 9 のいずれ一項に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、前記障壁は、前記第 1 回路素子に接続され、少なくとも前記障壁の側部における絶縁性コーティングを有する前記導電性障壁材料を与える金属コーティングを有する、ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

20

【請求項 12】

請求項 1 乃至 8 のいずれ一項に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、前記物理的障壁は、ビアが前記回路基板における前記回路素子との接続のために延びている絶縁性材料を主体としており、前記導電性障壁材料を提供する金属コーティングは、前記物理的障壁の上部において且つ前記障壁を通るビアにおいて延びている、ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

30

【請求項 13】

請求項 1 乃至 12 のいずれ一項に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、前記エレクトロルミネッセンス素子は有機半導体材料の電流駆動発光ダイオードである、ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 14】

請求項 1 乃至 13 のいずれ一項に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置であって、前記導電性障壁材料の下方において、第 1 回路素子への接続を可能にする前記回路基板における中間絶縁性層に接続窓がある、ことを特徴とするアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項 15】

請求項 1 乃至 14 のいずれ一項に記載のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置を製造する方法であって：

(a) 前記回路基板の前記第 1 回路素子への電極接続上に析出された電気導電性材料を有し、前記画素領域に隣接する前記物理的障壁の少なくとも側部において絶縁体を有する前記物理的障壁を形成する段階であって、前記物理的障壁は前記障壁の前記上部において前記導電性障壁材料への非絶縁性上部接続領域を有する、段階；

40

(b) 前記物理的障壁間に画素領域における前記エレクトロルミネッセンス素子の少なくとも一部を与える段階；及び

(c) 前記障壁の前記の非絶縁性上部接続領域における前記導電性障壁材料との接続において前記第 2 回路素子を与える段階；

50

有する、ことを特徴とする方法。

【請求項 16】

請求項 15 に記載の方法であって、前記絶縁体は、前記導電性障壁の少なくとも側部と上部とに析出され、前記上部接続領域から実質的にエッティングされる絶縁性コーティングを有する、ことを特徴とする方法。

【請求項 17】

請求項 15 に記載の方法であって、前記導電性障壁材料はアルミニウムを有し、前記絶縁体は陽極酸化により前記アルミニウムの障壁材料の側部に形成された絶縁性コーティングを有する、ことを特徴とする方法。

【請求項 18】

請求項 15 に記載の方法であって、前記段階 (a) は、ビアが前記回路基板の前記接続窓における前記回路素子との接続のために形成される絶縁性材料を主体とする物理的障壁を形成する手順を有し、前記電気導電性材料は前記物理的障壁の上部において且つ前記物理的障壁を通る前記ビアにおいて導電性コーティングとして析出される、ことを特徴とする方法。

【請求項 19】

請求項 18 に記載の方法であって、前記物理的障壁のための前記導電性コーティングと前記エレクトロルミネッセンス素子の上部電極は同時に析出され、前記物理的障壁の前記側部における突出形状のシャドーマスクの効果により分離される、ことを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、エレクトロルミネッセンス表示装置に関し、特に、半導体性共役系高分子又は他の有機半導体材料の発光ダイオードを用いることに限らないエレクトロルミネッセンス表示装置に関する。本発明は又、そのような装置の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

そのようなアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置は既知であり、その表示装置は、回路基板において存在する画素アレイを有し、各々の画素はエレクトロルミネッセンス素子であって、代表的には、有機半導体材料を有する。エレクトロルミネッセンス素子は、基板における回路構成であって、例えば、アドレス(行)ラインと信号(列)ラインとを有するマトリクス状アドレス回路構成及び供給ラインを有する駆動回路構成に接続される。これらのラインは、一般に、基板内の薄膜導体層により構成される。回路基板は又、各々の画素のためのアドレス素子及び駆動素子(代表的には、薄膜トランジスタであって、以下、“TFT”と表す)を有する。

【0003】

多くのそのようなアレイにおいては、絶縁材料の物理的障壁がアレイの少なくとも1つの方向における隣接画素間に存在する。そのような障壁の例は、英國特許出願公開大2347017号明細書、国際公開第1-99/43031号パンフレット、欧州特許出願公開第0895219号明細書、欧州特許出願公開第1096568号明細書及び欧州特許出願公開第1102317号明細書において提供されており、ここでは、それらの内容全てをもって参照文献として援用する。

【0004】

そのような障壁は、一部では、例えば、“壁”、“仕切り”、“バンク”、“リブ”、“分離帯”又は“ダム”的用語が用いられている。引用文献から理解されるように、幾つかの役割を果たしている。それらは、エレクトロルミネッセンス層並びに/若しくは個々の画素及び/又は画素の列の電極層を規定するために、製造において用いられることが可能である。このようにして、例えば、障壁は、単色表示のためにスピンドルコートされるか又はカラー表示の赤色、緑色及び青色画素のためにインクジェットプリントを施されること

10

20

30

40

50

が可能である共役系高分子材料の画素オーバーフローを回避する。製造される装置における障壁は、画素の明確化された光学的分離を提供することができる。障壁は又、エレクトロルミネッセンス素子の共通の上部電極の電気抵抗を減少（それ故、電圧降下）させるための補助配線としての導電材料（エレクトロルミネッセンス素子の上部電極材料等）を支持又はその材料から成ることが可能である。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

本発明の目的は、基本的な装置構造、そのレイアウト及びそのエレクトロニクスと適合する方式で、アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置の性能及び／又は能力を改善することである。 10

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明の1つの特徴に従って、請求項1に記載の特徴を有するアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置を提供する。

【0007】

本発明に従って、画素間の物理的障壁は、障壁の最上部に接続される第2回路素子と回路基板の第1回路素子との間の相互接続を提供するために用いられる。このように、これらの画素障壁は、部分的に、その相互接続を与える電気導電性材料（代表的には、金属）から成る一方、少なくともエレクトロルミネッセンス素子に隣接する障壁の側部において絶縁されている。 20

【0008】

本発明に従って、汎用性を高めることが可能である。種々のレイアウトの特徴が、相互接続される回路素子に依存して、画素障壁に対して採用されることができる。このようにして、導電性障壁材料は、例えば、画素のグループ又は個々の画素に局在化される相互接続、若しくは画素アレイの外部に位置付けることが可能である相互接続を提供することが可能である。それ故、各々の非絶縁性の最上部接続領域自身は、障壁の最上部に沿った接続パターンの一部として局在化されることが可能であり、及び／又は、相互接続する導電性障壁材料は、例えば、障壁の分離した絶縁性距離部において局在化されることが可能である。 30

【0009】

第1回路素子及び第2回路素子は、なされる特定の改善、エンハンスメント又は適応に依存して、種々の形態をとることが可能である。代表的には、回路基板の第1回路素子は、導体層、電極接続、供給ライン、アドレスライン、信号ライン、薄膜トランジスタ、薄膜コンデンサを有するグループにおける1つ又はそれ以上の薄膜素子であることが可能である。第2回路素子は、回路基板における他のそのような薄膜素子、及び／又は、例えば、それぞれの画素のエレクトロルミネッセンス素子又はセンサのような付加構成要素の電極接続であることが可能である。

【0010】

最後の可能性は、センサアレイの種々の形態が画素アレイと共に集積化されることを可能にする。センサアレイは回路基板内に集積化されることが可能である。しかしながら、センサアレイは、障壁の最上部及び画素アレイに亘って支持されることが可能である。このことはコンパクトなレイアウトを可能にし、指紋センシング及び／又は直接ペン入力のために特に適する。センサアレイは、回路基板における画素アレイのマトリクス状アドレス回路を共有することさえ可能である。このことは、画素アレイとセンサアレイとの集積化を簡単化する。共有化は、例えば、米国特許第5,386,543号明細書及び米国特許第5,838,308号明細書において開示されている方式と類似する方式で達成される。ここでは、米国特許第5,386,543号明細書及び米国特許第5,838,308号明細書の内容全てをもって参照文献として援用する。 40

【0011】

10

20

30

40

50

本発明に従った相互接続を提供するために障壁を用いる上に、障壁（又は、少なくとも他の分離した絶縁性距離部の障壁）は異なる役割を果たすことが可能である。障壁は、例えば、コンデンサ、インダクタ又はトランスのような構成要素を構成するために、及び／又は、回路基板の薄膜導体ラインを置き換える又はバックアップするために、用いられることが可能である。これらのバックアップライン又は置き換えラインは、例えば、アドレスライン、信号ライン又は供給ラインであることが可能である。

【0012】

又、本発明の他の特徴に従って、アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置等を製造する優位性のある方法を提供する。

【0013】

本発明に従った種々の優位性のある特徴及びそれらの特徴の組み合わせについては、同時提出の請求項に記載している。以上の及び他の特徴は、添付図面を参照して、例示として以下に説明する本発明の実施形態において明らかにする。

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

全ての図は模式図であることに留意する必要がある。それらの図の構成部分の関連する寸法及び比率は、描く際の都合と明確化のために、サイズを拡大又は縮小することにより示している。一般に、変形された実施形態及び異なる実施形態における対応する特徴又は類似する特徴を表すために同じ参照符号を用いている。

【0015】

各々の図1乃至4の実施形態のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置は、マトリクスアドレス回路構成を有する回路基板100上の画素200のアレイを有する。物理的障壁210は、そのアレイの少なくとも1つの方向において少なくとも幾つかの隣接画素間にある。これらの障壁210の少なくとも幾つかは、本発明に従った相互接続として用いられる導電性障壁材料240を用いて構成される。本発明に従った障壁210の使用及びこの特別な構成を除いて、表示装置は、上記の背景的参照文献におけるように、既知の装置技術と回路技術を用いて構成されることが可能である。

【0016】

マトリクスアドレス回路構成は、図1に示すように、アドレス（行）ライン150及び信号（列）ライン160の横断的集合それぞれを有する。アドレス素子T2（代表的には、薄膜トランジスタ、以下、“TFT”と表す）は、これらのアドレス（行）ライン150及び信号（列）ライン160の各々の交差部分において、組み込まれる。図1は、例として、1つの特定の画素回路構成を示していることが理解される必要がある。他の画素回路構成が、アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置に対して知られている。装置の特定の画素回路構成に拘らず、そのような装置の画素障壁に本発明を適用することが可能であることは、容易に理解される必要がある。

【0017】

各々の画素200は、電流駆動エレクトロルミネッセンス素子25（21、22、23）であって、代表的には、有機半導体材料の発光ダイオード（LED）を有する。LED25は、アレイの2つの電圧供給ライン140と230との間の駆動素子T1（代表的には、TFT）と直列の状態に接続される。これらの2つの供給ラインは、代表的には、電力供給ライン140（電圧Vddを有する）及びグラウンドライン230（また、“リターンライン”という）である。LED25からの発光は、各々の駆動TFT T1により変えられるように、LED25を通る電流により制御される。

【0018】

画素の各々の行は、関連する行導体150（それ故、行の画素のアドレスTFT T2のゲート）に印加される選択信号により、フレーム期間において順にアドレスされる。この信号はアドレスTFT T2をオンにし、それ故、列導体160からのそれぞれのデータ信号を有する行の画素をロードする。これらのデータ信号は、それぞれの画素の個々の駆動TFT T1のゲートに印加される。その駆動TFT T1の結果として得られた

導通状態を保持するために、このデータ信号は、このゲート5と駆動ライン140、240との間に結合される保持キャパシタChによりゲート5において維持される。このように、各々の画素200のLED25を流れる駆動電流は、前アドレス期間の間に印加され、関連するキャパシタChにおいて電圧として蓄積された駆動信号に基づいて、TFT T1により制御される。具体例の図1においては、T1はPチャネルTFTとして示され、T2はNチャネルTFTとして示されている。

【0019】

この回路構成は、既知の薄膜技術を用いて構成されることがある。基板100は、例えば、シリコン酸化物の絶縁性表面バッファ層11が析出された絶縁性ガラス基材10を有することが可能である。薄膜回路構成は、既知の方法で絶縁性表面バッファ層11上に形成される。

【0020】

図2及び3は、TFTの例Tm及びTgであって、各々は、活性半導体層1（代表的には、ポリシリコン）、ゲート誘電体層2（代表的には、シリコン酸化物）、ゲート電極5（代表的には、アルミニウム又はポリシリコン）、及び重ね合わされた絶縁層2及び8における窓部（ビア）を通って半導体層1のドーピングソース及びドレイン領域に接している金属電極3及び4（代表的には、アルミニウム）をそれぞれ有する、TFTの例Tm及びTgを示している。電極3、4及び5の延長は、特定のTFT（例えば、駆動素子T1、アドレス素子T2又は回路基板の他のTFT）により与えられる回路機能により、例えば、電極T1、T2、Ch及びLED25並びに／若しくは導電ライン140、150及び160の間の相互接続を構成する。維持キャパシタChは、回路基板100内部の薄膜構造として、既知の方法で、形成されることが可能である。

【0021】

LED25は、代表的には、下部電極21と上部電極23との間の発光有機半導体材料22から構成される。好適な具体的な実施形態においては、半導体性共役系高分子は、エレクトロルミネッセンス材料22に対して用いられることが可能である。基板を透過して光250を発光するLEDに対して、下部電極21はITO（Indium Tin Oxide）より成る陽極であることが可能であり、上部電極23は、例えば、カルシウム及びアルミニウムから構成される陰極であることが可能である。図2及び3は、下部電極が回路基板100における薄膜として形成されるLEDを示している。次のドーピング有機半導体材料22は、基板100の薄膜構造に亘って延長されたブレーナ絶縁層12（例えば、シリコン窒化物）における窓部12aの薄膜電極層21に接している。

【0022】

既知の装置におけるように、本発明に従った図1乃至4の装置は、アレイの少なくとも1つの方向における少なくとも幾つかの隣接画素間ににおいて、物理的障壁210を有する。これらの障壁210には又、例えば、“壁”、“仕切り”、“バンク”、“リブ”、“分離帯”又は“ダム”の用語が用いられる。具体的な装置の実施形態及びその製造方法に依存して、それらは既知の方式で用いられる。例えば、

半導体性高分子層22を調整する間に、個々の画素200のそれぞれの領域及び／又は画素200の列との間の高分子溶液のオーバーフローを回避して、分離する。

個々の画素200及び／又は画素の列のための他のエレクトロルミネッセンス層22または半導体性高分子（或いは、画素のための個々の電極であって、例えば、上部電極23の個々の下層の自己分離でさえ）の範囲限定において基板表面にセルフパターニング能力を提供する。

少なくとも有機半導体材料22及び／又は電極材料の析出の間に基板表面に亘るマスクのためのスペーサとして機能する。

光250が上部を透過して発光されるとき、アレイにおける画素200の明確に限定された光学的分離のための不透明障壁210を（底部基板100の代わり又はそれと併せて）構成する。

【0023】

10

20

30

40

50

これらの既知の方式における具体的な使用がどのようなものであろうと、本発明の実施形態における物理的障壁 210 の少なくとも一部の絶縁部分は、特定の方式で用いられ、構成される。それ故、図 2 乃至 4 の画素障壁 210 は、LED 25 から絶縁され、回路基板 100 の第 1 回路素子と装置の第 2 回路素子との間の相互接続を与える金属 240 (又は、他の電気導電性材料 240) を有する。これらの回路素子は、導電性障壁材料 240 の非絶縁性底部及び上部接続領域 240b、240t に接続される。

【0024】

第 1 回路素子及び第 2 回路素子は、なされる特定の改善、向上又は適合に従って、種々の形態をとることが可能である。代表的には、回路基板 100 の第 1 回路素子は、導体層及び / 又は電極接続 4、5、6、供給ライン 140、アドレスライン 150、信号ライン 160、薄膜トランジスタ T1、T2、Tm、Tg、及び薄膜キャパシタ Ch を有するグループの 1 つ又はそれ以上の薄膜素子であることが可能である。第 2 回路素子は、回路基板 100 における他のそのような薄膜素子、及び / 又は、例えば、それぞれの画素の LED 25 の電極接続又はセンサのような付加構成要素であることが可能である。

【0025】

図 2 乃至 4 は非絶縁性上部接続領域 240t を示しているが、いずれの接続される特定の第 2 回路素子 (上部回路素子 400) を伴っていない。第 2 回路素子の特定な例については、図 5 乃至 8 を参照して、下に説明している。しかしながら、本発明は、本発明に従って、そのような画素障壁 210 により回路基板 100 における回路構成への多種多様の上部回路素子 400 の相互接続に適用されることが可能であること、を容易に理解される必要がある。

【0026】

図 2 の実施形態においては、第 1 回路素子は、TFT Tm のソース電極及び / 又はドレイン電極の延長である。第 1 回路素子は、例えば、Tm が T2 であるとき、基板回路構成の信号 (列) ライン 160 を、Tm が T1 であるとき、駆動ライン 140 を構成することが可能である。図 3 の実施形態においては、第 1 回路素子は TFT Tg のゲート電極の延長である。第 1 回路素子は、例えば、Tg が T2 であるとき、基板回路構成のアドレス (行) ライン 150 を構成することが可能である。

【0027】

図 2 及び 3 は、中間絶縁層 12 の接続窓 12b における第 1 回路素子 4、5 への導電性障壁材料 240 の底部接続を示している。しかしながら、これらの窓 12b は、しばしば、TFT Tm、Tg と同じ面内にあることが可能である。特に、窓 12b を収めるには、TFT Tg のソース電極 3 とドレイン電極 4 との間には、一般に、十分な空間がない。それ故、窓 12b は、図の紙面の外側の位置に示すために、図 3 においては破線の輪郭で示されている。

【0028】

図 2 乃至 4 の実施形態における画素障壁 210 は、電気導電性材料 240、240x 主体とし、好適には、非常に小さい非抵抗を有する金属 (例えば、アルミニウム、銅、ニッケル又は銀) を有する。図 2 及び 3 の障壁 210 は、相互接続 240 を与え、側部と上部表面 (上部接続領域 240 が露出されたところを除く) における絶縁性コーティングを有する導電性材料のバルク (bulk) 又はコア (core) を有する。図 4 の障壁 210 は、側部及び上部表面に絶縁性コーティング 40x を有する導電性材料のバルク又はコアを有する。図 4 における相互接続 240 を与える導電性材料は、絶縁性コーティング 40x 上に延びる金属コーティングである。絶縁性コーティング 40 は、上部接続領域 140t が露出されたところを除いて、金属コーティング 240 の側部及び上部表面において延びている。このような図 4 の構造は、図 2 及び 3 の構造に比べて用途が広い。その構造は、金属コア 240x が他の目的で用いられること、例えば、駆動ライン 140、アドレスライン 150 又は信号ライン 160 をバックアップする又はそれらを置き換えることさえ可能にする。相互接続金属コーティング 240 は、これらの相互接続が必要とされるところを、例えば、個々の画素又は副画素において、障壁 210 に沿ったと規定の位置に局在さ

10

20

30

40

50

れることさえ可能である。

【0029】

センサ領域を伴う図5乃至7の実施形態

図5乃至7の実施形態の各々においては、センサ400sのアレイは画素200のアレイと共に集積されている。センサ400sは、回路基板100の第1回路素子に導電性障壁材料240により接続される第2回路素子400を提供する。種々のセンサアレイは、本発明に従って、表示装置と共に集積されることが可能である。このようにして、センシングアレイは、例えば、短絡タッチ入力、圧力入力、コンテンサ入力又は光ペン入力を有する。

【0030】

二次元センサアレイからの個々の相互接続に対して、導電性障壁材料240は、一般に、個々のセンサ400sに対応して、障壁210におけるそれぞれの絶縁性距離部に分割される。

【0031】

このような集積化センサの状態において、第1回路素子は、例えば、基板100におけるTFTのソース／ドレイン4又はゲート5であることが可能である。好適には、第1回路素子は、画素200のアレイ及びセンサ200sのアレイの両方に対するマトリクス状アドレス回路構成の一部である。このようにして、第1回路素子は、画素アドレッシングのためのTFT T2のソース／ドレインライン4、160であることが可能である。

【0032】

図5乃至7の実施形態の各々においては、センシング能力は、光が発光される表示装置の前面において提供される。センサアレイは、障壁210の上部において及び画素アレイに亘って支持されている。絶縁性平坦化層412は、画素アレイに亘ってセンサアレイを支持するために、障壁210の上部に延びるある膜厚を有して、画素アレイを覆って存在している。図5乃至8は、図2及び3におけるような相互接続金属コア構造を示しているが、例えば、図4におけるような相互接続金属コア構造をもちいて、改善することが可能である。

【0033】

図5の実施形態は、誘電体又は高抵抗材料の圧縮性層22を有する圧力センサ構造を示している。この圧縮性層は、例えば、ITOから成る透明な上部電極層423、下層導電性障壁材料240及び絶縁性平坦化層412の間に積層される。上部電極層423は保護層440をコーティングされる。圧力500がこの積層構造に印加されるとき、電極層423と導電性障壁材料との間の間隔は変化して、誘電体の容量における測定可能な変化か又は高抵抗材料の抵抗の減少を生じる。これは、電極層423が又回路入力のためのESD保護を提供するという点で、最も優位性のある実施形態である。

【0034】

図6は、例えば、指紋センサのような静電容量性センサを示している。ITO又は金属の電極パッドのアレイは、キャパシタ誘電層430を有するそれぞれのキャパシタの1つのプレートを構成するために、導電性障壁材料240の対応するアレイの上部に接続されている。

【0035】

図7は、導電性障壁材料240の対応するアレイの上部に接続されたITOの電極パッド424を有する直接入力センサを示している。直接入力は、例えば、電極パッド424に接触する有線ペンからの電流又は電圧入力であることが可能である。又、直接入力は、隣接パッド424間であって、例えば、行導体150に接続されたパッド424と列導体160に接続されたパッド424との間の（無線）導電性ペンによる短絡であることが可能である。そのような短絡から生じる電流は、どの画素が短絡しているかを判定するために、表示装置の外部において測定ができる。

【0036】

画素又は副画素相互接続を有する図8の実施形態

10

20

30

40

50

図8の実施形態における第2回路素子は、回路基板100の薄膜素子に導電性障壁材料240により接続されたLED25の上部電極である。そのような相互接続は、所定のLED25の電極21及び23の両方への回路構成の集積を可能にする。

【0037】

しかしながら、図8における具体的な実施形態においては、導電性障壁材料240の底部接続は、隣接LED25の下部電極を構成する薄膜素子へのものである。そのような構成には、例えば、障壁210を有する隣接した副画素を有する各々の画素を、表示装置に対して導入されることができる。この場合、導電性障壁材料240は、副画素200bの上部電極23を隣接副画素200aの下部電極21に接続している。

【0038】

図9、図10及び図11のレイアウトについての実施形態

本発明に従って、装置における相互接続障壁材料240に対して、多種多様のレイアウト構成が可能である。有利なことに、相互接続障壁材料240は、画素間の障壁210×の他の部分と、複合レイアウトにおいて、結合されることが可能である。

【0039】

図9及び10は、付加障壁部分210×の導電性障壁材料240×が、基板100の駆動供給ライン140をバックアップすること又はそれらラインを置き換えることさえ可能であることを示している。マトリクス状薄膜回路領域は、図9における120のように設計されている。この具体的な例においては、相互接続障壁材料240の絶縁性距離部は、付加障壁ライン210×、140に平行に延びている。

【0040】

図11は、付加障壁部分210×(240×、40×)は相互接続障壁材料240を横断している。この場合、付加障壁部分210の導電性障壁材料240×は、基板100の駆動ライン140、アドレスライン150又は信号ライン160をバックアップすること又はそれらを置き換えることさえ可能である。又、付加障壁部分210×は、図7におけるような直接入力センサアレイのための横断的相互接続を構成することが可能である。

【0041】

図12の向上した障壁の実施形態

図2乃至8及び図10の実施形態においては、障壁210及び210×は、導電性材料240及び240×を主体とするものとして示されている。図12は、障壁210が絶縁性材料244を主体としていることを示している。この場合、ピア244bはエッチングされ、回路基板100における回路素子4,5の方に絶縁性材料244を通して成形される。金属コーティング240は、絶縁性障壁210の上部及びピア244bにおいて延びる導電性障壁材料を提供する。

【0042】

障壁210の金属コーティング240は、セルフアライメント方式で、LED25の上部電極23の主要部分23aと共に、同時に形成されることが可能である。それ故、図12に示すように、障壁210の側部における突出形状のシャドーマスクの効果により分離される電極23と金属コーティング240とのために、金属層が同時に接出されることが可能である。これは、本発明に従った、障壁相互接続210、240を形成するための1つの有効なプロセスの実施形態である。図14乃至17は、金属を主体とする障壁相互接続210、240のための他のプロセスの実施形態を示している。

【0043】

図13乃至16のプロセスの実施形態

相互接続材料240と共に障壁210を用いて構成すること以外に、本発明に従ったアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置は、例えば、上記の背景としての参照文献におけるように、既知の装置技術及び回路技術を用いて、構成されることが可能である。

【0044】

10

20

30

40

50

図13乃至16は、具体的な製造の実施形態における新規なプロセス段階を示している。上部プレーナ絶縁性層12（例えば、シリコン窒化物）を伴う薄膜回路基板100は、既知の方法で製造される。接続窓（例えば、ビア12a、12b、12x等）は、例えば、フォトリソグラフィのマスキング及びエッチングにより、既知の様式で、上部プレーナ絶縁性層12に開けられる。しかしながら、本発明に従って装置を製造するために、これらのビアのパターンは、導電性障壁材料240、240xとの底部接続のために、金属電極4、ゲート電極5、アドレスライン150等を延長するビア12b、12xを有する。結果的に得られた構造を図13に示している。この段階は、障壁210が、図2乃至8及び図10におけるように導電性材料を主体とするものであるか又は図12におけるように絶縁性材料を主体とするものであるかに拘らず、共通である。

10

【0045】

絶縁性材料を主体とする障壁210の形成については、図12を参照して、上で説明した。導電性材料を主体とする障壁210のための適切なプロセスの段階（図2乃至及び図10）については、図14乃至16を参照して、以下、説明する。

【0046】

この場合、障壁210のための電気導電性材料は、少なくともビア12a、12b、12x等における絶縁性層12上に析出される。障壁210に対する好ましい距離及びレイアウトパターンは、既知のマスキング技術を用いることにより、得られる。図14は、少なくとも導電性障壁材料（例えば、銅、ニッケル又は銀）のバルクがメッキ法により析出される実施形態を示している。この場合、先ず、例えば、銅、ニッケル又は銀から成る薄い種の層240aが絶縁性層12とビア12a、12b、12x等を覆って析出され、障壁のレイアウトパターンはフォトリソグラフィのマスクを用いて規定され、次いで、導電性障壁材料のバルク240が好ましい膜厚にメッキ法により形成される。結果的に得られる構造については、図14に示している。

20

【0047】

次いで、CVD（Chemical Vapour Deposition：化学的気相成長法）を用いて、絶縁性材料（例えば、シリコン酸化物又はシリコン窒化物）が絶縁性コーティング40のために析出される。この析出された材料は、既知のフォトリソグラフィのマスキング及びエッチング技術を用いて、パターニングすることにより、導電性障壁材料の側部及び上部表面に残される。この後、LED25を形成するために、既知の方法において製造が継続される。このように、例えば、共役系高分子材料22は、画素200のために、インクジェットを用いて印刷されるか又はスピンドルコートされることが可能である。絶縁コーティング40を伴う障壁240、40は、物理的障壁240、40の間ににおける画素領域からの高分子のオーバーフローを防止するために、既知の方法において用いられることができる。上部電極材料23は共役系高分子材料22上に析出される。結果として得られる構造については、図15に示している。

30

【0048】

この後、図5乃至7のセンサの場合は、平坦化材料412'の層がLED25を覆って形成される。この平坦下層412'は、障壁210の上部における絶縁性コーティング40を露出するためにエッチバックされることが可能である。絶縁性コーティング40のこの露出された上部部分は、次いで、図16に示すように、障壁210の非絶縁性上部接続領域240tを形成するためにエッチングにより除去されることが可能である。センサ構造は、次いで、この接続領域240tと平坦化層412の上部に与えられる。

40

【0049】

図17の向上したプロセスの実施形態

この実施形態は、画素領域に隣接する障壁210の少なくとも側部に絶縁性コーティングを与えるために、陽極酸化処理法（析出の代わりに）を用いる。代表的には、導電性障壁材料240はアルミニウムを有することが可能である。析出されるアルミニウムの好ましい距離とレイアウトパターンとは、既知のフォトリソグラフィのマスキング及びエッチング技術を用いて、限定されることができる。図17は、アルミニウムの障壁パターン2

50

40の上部に保持されたフォトリソグラフィにより限定されるエッチャントマスクを示している。

【0050】

次いで、アルミニウム酸化物から成る陽極酸化による絶縁性コーティングは、既知の陽極酸化技術を用いて、アルミニウムの障壁材料240の少なくとも側部において形成される。それ故、このコーティング40に対して、レイアウトを規定するために、付加マスクは必要とされない。

【0051】

図17に示すように、マスク44は、非絶縁性の上部接続領域240tを形成する及び保護することを所望される領域において、この陽極酸化の間に保持されることができる。この場合、陽極酸化によるコーティングは、アルミニウム障壁パターン240の側部のみにおいて形成される。マスク44は、陽極酸化によるコーティングがアルミニウムの障壁パターン240の上部及び側部の両方において必要とされる領域から、この陽極酸化の前に除去されることが可能である。又、絶縁性高分子、又は、例えば、シリコン酸化物又はシリコン窒化物から成るマスク44は、製造される装置における障壁210(240、40)の上部において絶縁性が所望されるこの領域において保持されることが可能である。

【0052】

上記の実施形態においては、導電性障壁材料240は、厚い不透明な金属、例えば、アルミニウム、銅、ニッケル又は銀である。しかしながら、他の導電性材料240、例えば、絶縁性コーティング40を形成するために表面酸化されることが可能である、金属シリサイド又は(有利ではないが)縮退ドーピング(degenerately-doped)ポリシリコンを用いることが可能である。透明な障壁210が必要とされる場合、ITOが導電性障壁材料240のために用いられることが可能である。更に、回路基板100の導体ライン(例えば、駆動ライン140、アドレスライン150又は信号ライン160)をバックアップするため又はそれを置き換えるために、導電性障壁材料240、240xを用いることにより、ライン抵抗は著しく低減されることに留意する必要がある。このように、所定のラインに沿って、導電性障壁材料240は、回路基板100における代表的な導体層(例えば、TFT-Tmのソース/ドレインライン4、6(140、160)又はTFT-Tgのゲートライン5(150))の断面積より少なくとも2倍大きい(恐らく、同等の大きさのオーダーの)断面積を有することができる。代表的には、導電性障壁材料240は、回路基板100におけるこのTFT導体層の膜厚zより2倍又はそれ以上大きい(例えば、少なくとも5倍)膜厚Zを有することが可能である。具体的な例においては、Zは、zの0.5μm又はそれ以下に対して、2μm乃至5μmの範囲内とすることが可能である。代表的には、導電性障壁材料240は、TFT導体層のライン幅yと同じ幅(又は、少なくとも2倍大きい)であるライン幅Yを有することが可能である。具体的な例において、Yは、yの10μmに対して、20μmとすることが可能である。

【0053】

本発明の開示内容を読むことにより、他の種々の改善が可能であることが、当業者に理解されるであろう。そのような種々の改善は、当該技術分野において既に周知であり、以上で述べた特徴に付加して又はそれらの特徴の代わりとして用いられることが可能である、同等の他の特徴を有することが可能である。

【0054】

請求項は、具体的な特徴の組み合わせへの本発明の適用において策定されたが、本発明がいずれの請求において以前に請求された発明と同じ発明に関係するか否かに拘らず、そして、本発明が改善するのと同様な技術的問題点の全て又はいずれかを改善するか否かに拘らず、本発明の開示範囲は又、いずれの新規な特徴、明瞭に又は暗示的に以上で開示された特徴のいずれの新規な組み合わせ、又は特徴のいずれの一般化を有することが理解される必要がある。

【0055】

10

20

30

40

50

本出願人は、それ故、本発明の出願又は本発明から誘導されるいづれの更なる出願の手続の間に、いづれのそのような特徴及びノ又はそのような特徴の組み合わせに対して新たな請求項が策定され得ることを知らせておくこととする。

【図面の簡単な説明】

【0056】

【図1】本発明に従った相互接続を備えることができるアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置の4つの画素領域についての回路図である。

【図2】本発明に従ったTFTのソースライン又はドレインラインへの相互接続を形成するための導電性障壁構成の一例を示す、装置の一実施形態の回路基板と画素アレイの一部の断面図である。10

【図3】本発明に従ったTFTのソースライン又はドレインラインへの相互接続を形成するための導電性障壁構成の他の一例を示す、装置の類似する実施形態の回路基板と画素アレイの一部の断面図である。

【図4】本発明に従った相互接続を形成するための金属コーティングを用いる向上した導電性障壁構成の一例を示す、図2又は図3の実施形態のような相互接続の断面図である。

【図5】エレクトロルミネッセンス装置を集積した圧力センサのための本発明に従った相互接続を示す、図2又は図3のような装置の一部を示す断面図である。

【図6】エレクトロルミネッセンス装置を集積した静電容量性センサのための本発明に従った相互接続を示す、図2又は図3のような装置の一部を示す断面図である。

【図7】エレクトロルミネッセンス装置を集積した直接入力センサのための本発明に従った相互接続を示す、図2又は図3のような装置の一部を示す断面図である。20

【図8】隣接画素又は副画素の上部電極と下部電極との間の本発明に従った相互接続を示す、図2又は図3のような装置の一部を示す断面図である。

【図9】隣り合った導電性障壁を伴う、本発明に従った装置の具体的な実施形態のためのレイアウトの具体的な例を示す4つの画素領域の平面図である。

【図10】図9のラインX-Xにおいて得られる、図9の隣り合った障壁を通る断面図である。

【図11】横断的導電性障壁を伴う、本発明に従った装置の具体的な実施形態のためのレイアウトの特徴の他の例の平面図である。

【図12】本発明に従った相互接続を形成するための導電性障壁構成の他の例を有する装置の一部の断面図である。30

【図13】本発明に従った具体的な一実施形態を用いた製造の段階における図2又は図3のような装置の一部の断面図である。

【図14】本発明に従った具体的な一実施形態を用いた製造の段階における図2又は図3のような装置の一部の断面図である。

【図15】本発明に従った具体的な一実施形態を用いた製造の段階における図2又は図3のような装置の一部の断面図である。

【図16】本発明に従った具体的な一実施形態を用いた製造の段階における図2又は図3のような装置の一部の断面図である。

【図17】本発明に従った導電性障壁の相互接続の絶縁体における改善を示す絶縁段階における装置の一部の断面図である。40

【 図 1 】

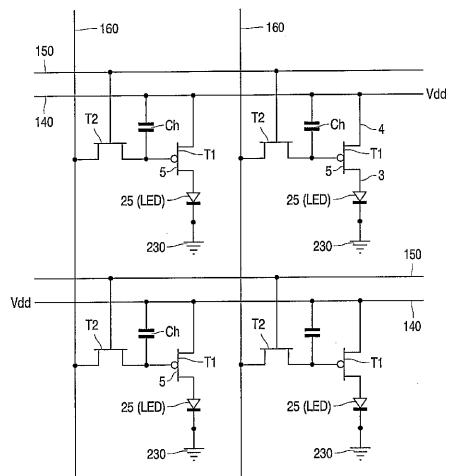


FIG. 1

【 图 2 】

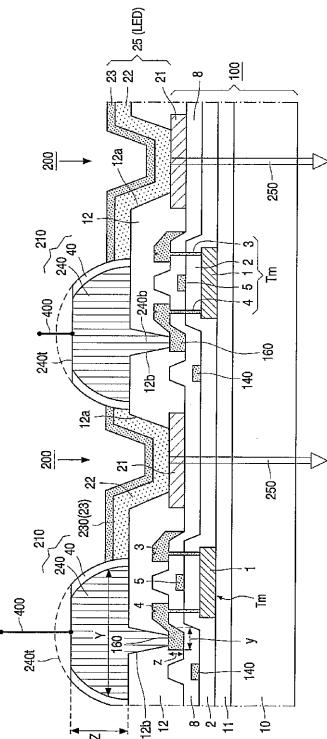


FIG. 2

【 図 3 】

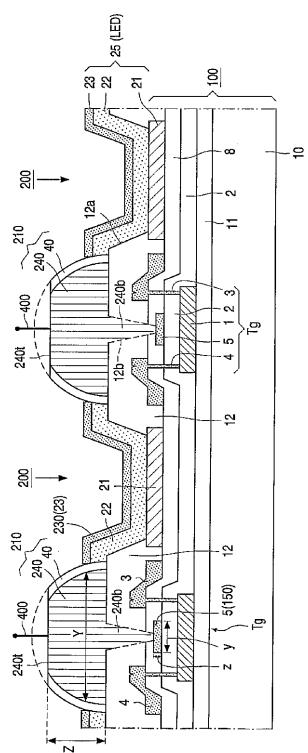


FIG. 3

【 4 】

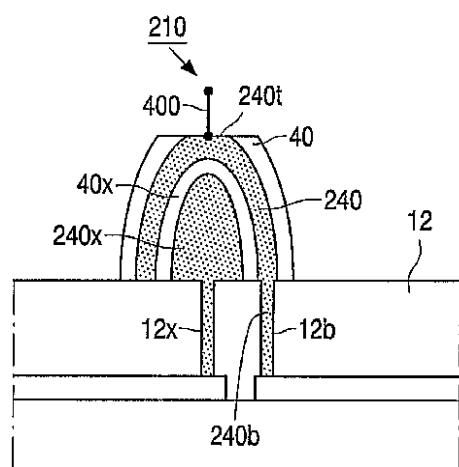


FIG. 4

【図5】

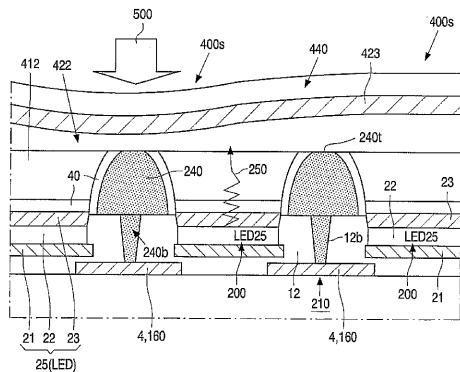


FIG. 5

【図6】

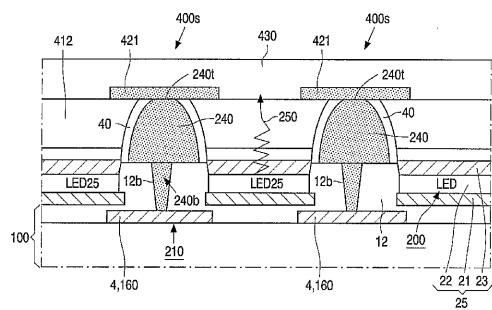


FIG. 6

【図7】

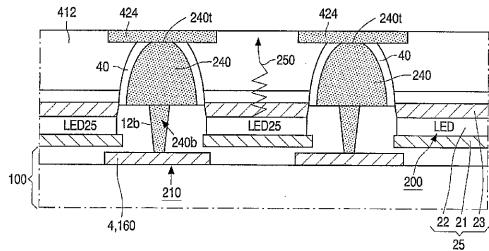


FIG. 7

【図8】

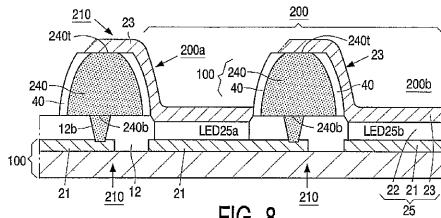


FIG. 8

【図9】

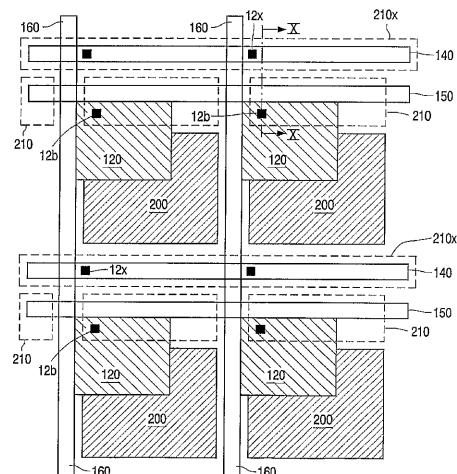


FIG. 9

【図10】

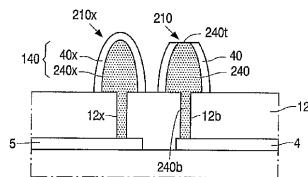


FIG. 10

【図11】

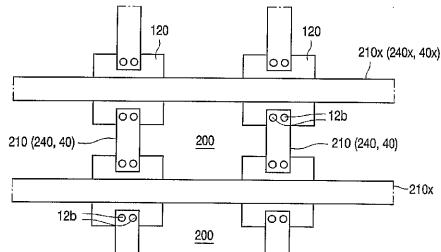


FIG. 11

【図12】

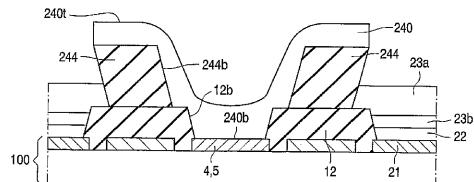


FIG. 12

【図13】

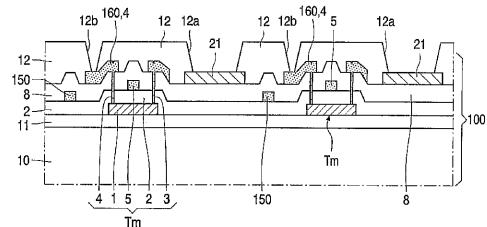


FIG. 13

【図14】

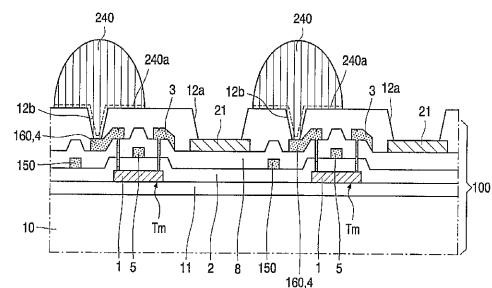


FIG. 14

【図15】

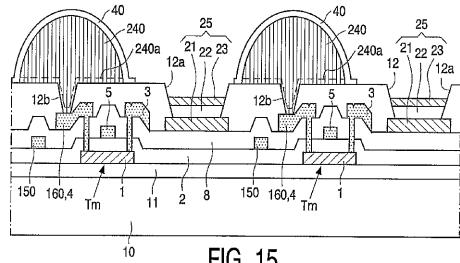


FIG. 15

【図16】

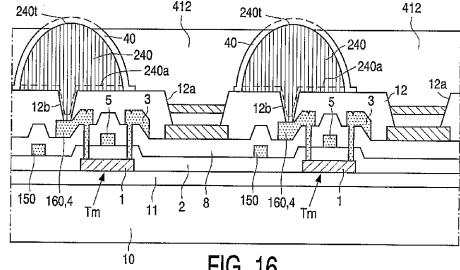


FIG. 16

【図17】

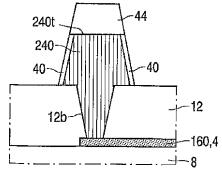


FIG. 17

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		Internal Application No PCT/ 03/01000
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L27/15 H01L51/20		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category ^a	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 307 528 B1 (YAP DANIEL) 23 October 2001 (2001-10-23) column 5, line 46 - line 51 abstract ---	1-19
A	EP 1 096 568 A (SONY CORP) 2 May 2001 (2001-05-02) abstract; figure 1 ---	1-19
A	WO 01 39272 A (DEURZEN MARIA H W A VAN LIEDENBAUM COEN T H F (NL); DUINEVELD PAU) 31 May 2001 (2001-05-31) abstract; figure 2 ---	1-19
A	EP 1 102 317 A (SONY CORP) 23 May 2001 (2001-05-23) abstract; figure 1 -----	1-19
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C.		<input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		
<p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "S" document member of the same patent family</p>		
Date of the actual completion of the international search 2 July 2003		Date of mailing of the international search report 17 JUL 2003
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.O. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel: (+31-70) 340-2040, Tx: 31 651 epo nl Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer DANIEL MOE/JA A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT, B 03/01000

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 6307528	B1	23-10-2001	NONE		
EP 1096568	A	02-05-2001	EP 1096568 A2 JP 2001195008 A TW 471237 B	02-05-2001 19-07-2001 01-01-2002	
WO 0139272	A	31-05-2001	CN 1353866 T CN 1345469 T WO 0139272 A1 WO 0141229 A1 EP 1153445 A1 EP 1153436 A1 JP 2003515909 T TW 478187 B	12-06-2002 17-04-2002 31-05-2001 07-06-2001 14-11-2001 14-11-2001 07-05-2003 01-03-2002	
EP 1102317	A	23-05-2001	JP 2001148291 A EP 1102317 A2	29-05-2001 23-05-2001	

フロントページの続き

(51) Int.Cl.⁷

F I

テーマコード(参考)

H 05 B 33/14

A

(81) 指定国 AP(GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IT,LU,MC,NL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NI,NO,NZ,OM,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(74) 代理人 100107766

弁理士 伊東 忠重

(72) 発明者 ヤング, ナイジェル ディー

オランダ国, 5656 アーアー アンドーフェン, プロフ・ホルストラーン 6

(72) 発明者 チャイルズ, マーク ジェイ

オランダ国, 5656 アーアー アンドーフェン, プロフ・ホルストラーン 6

(72) 発明者 フィッシュ, デイヴィッド エイ

オランダ国, 5656 アーアー アンドーフェン, プロフ・ホルストラーン 6

(72) 発明者 ヘクター, ジェイソン アール

オランダ国, 5656 アーアー アンドーフェン, プロフ・ホルストラーン 6

F ターム(参考) 3K007 AB11 AB18 BA06 DB03 EA00 FA00 GA00

5C094 BA03 BA29 CA19 DA13 EA10

专利名称(译)	有源矩阵电致发光显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	JP2005521207A	公开(公告)日	2005-07-14
申请号	JP2003577343	申请日	2003-03-19
[标]申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦电子股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦电子股份有限公司的Vie		
[标]发明人	ヤング,ナイジェル,ディー チャイルズ,マーク,ジェイ フィッシュ,デイヴィッド,エイ ヘクター,ジェイソン,アール		
发明人	ヤング,ナイジェル,ディー チャイルズ,マーク,ジェイ フィッシュ,デイヴィッド,エイ ヘクター,ジェイソン,アール		
IPC分类号	H05B33/22 G09F9/30 H01L27/15 H01L27/32 H01L51/50 H05B33/10 H05B33/12 H05B33/14		
CPC分类号	H01L27/3276 H01L27/3204 H01L27/3225 H01L27/3244 H01L27/3246		
FI分类号	H05B33/22.Z G09F9/30.338 G09F9/30.365.Z H05B33/10 H05B33/12.B H05B33/14.A		
F-TERM分类号	3K007/AB11 3K007/AB18 3K007/BA06 3K007/DB03 3K007/EA00 3K007/FA00 3K007/GA00 5C094 /BA03 5C094/BA29 5C094/CA19 5C094/DA13 5C094/EA10		
代理人(译)	伊藤忠彦		
优先权	2002006551 2002-03-20 GB 2002009562 2002-04-26 GB 2002016055 2002-07-11 GB		
其他公开文献	JP4360918B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

物理屏障 (210) 位于有源矩阵电致发光显示器的电路基板 (100) 上的相邻像素 (200) 之间，特别是有机半导体材料的LED (25)。本发明涉及第一电路元件 (21,4,5,6,140,150,160 , T1 , T2 , Tm , Tg , Ch) 和电路板的第二电路元件，例如，跨越像素阵列形成具有导电材料 (240) 的屏障 (210)，该导电材料用作所支撑的传感器阵列的传感器 (400s) 之间的互连。导电阻挡材料 (240) 在邻近LED的屏障侧上绝缘，并且非绝缘上连接区域，其中第二电路元件 (400,400s , 23) 连接到导电阻挡材料 (240) 它有 (240 吨) 。

